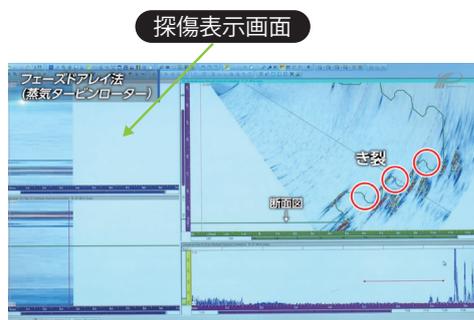
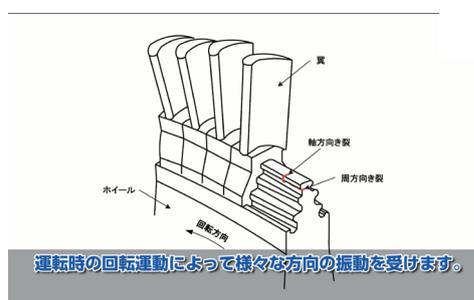


フェーズドアレイ法超音波探傷検査

画像描画方法による探傷試験によって、きずの形状や寸法評価が格段に向上し
精密な試験が実施可能です

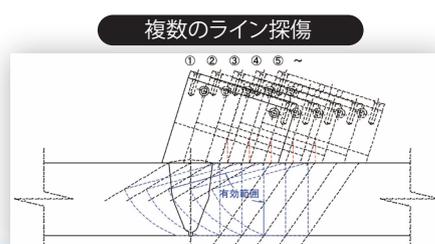
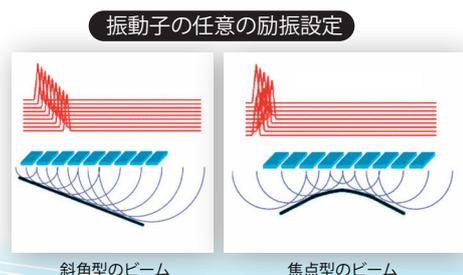
- ◆最大128chの同時励振が可能のため、暑い試験体に優位。
- ◆任意のビーム角度、焦点距離でのフォーカスが可能なため、きず形状や寸法精度が向上。
- ◆リアルタイムの画像処理で各種断面画像できずの状況を確認。任意箇所の詳細結果表示が可能。

植込み部フェーズドアレイ探傷

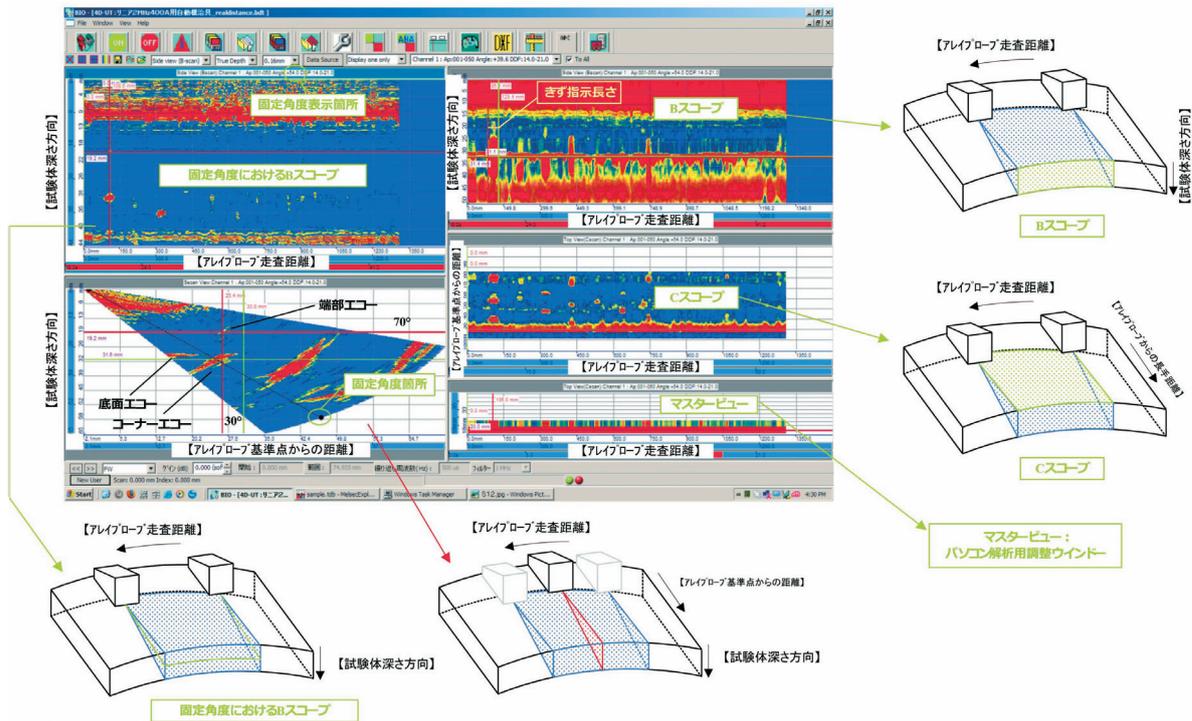


探傷方法

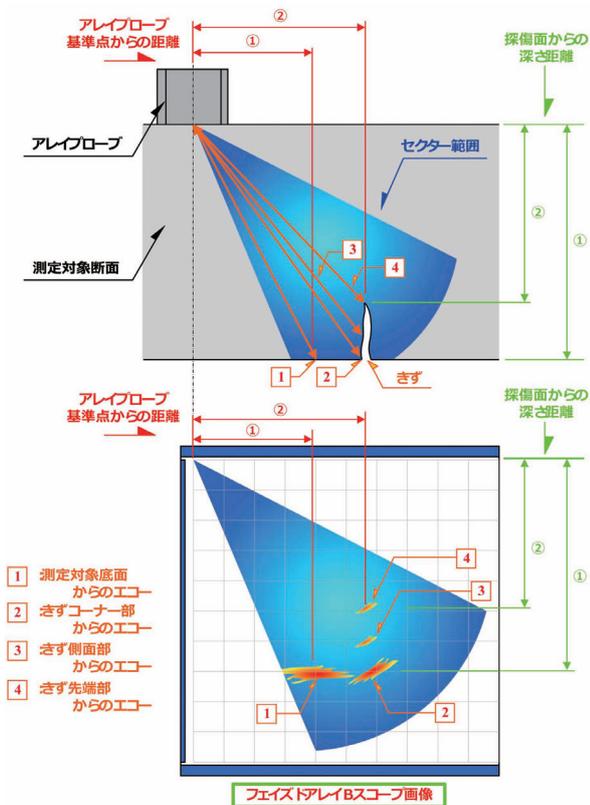
- ◆任意の振動子の励振設定により、自由にビーム角度、焦点距離を可変。その条件で複数ラインの探傷を行い、きずに対し最適な探傷条件を選定。
- ◆得られたデータを高速で処理し、各種断面に画像化して解析を行う。



探傷表示画面(各種断面画像)



Bスコープ詳細表示及び解説



特徴

- ◆特殊マトリクスプローブでの探傷が可能 (アレイローブ®, TRL® ローブ®)
- ◆任意のスキャン走査の設定が可能
- ◆3次元データ解析が可能
- ◆様々なロボットや走査治具の組合せによる、複数走査ラインデータの合成、詳細データによる総合評価が可能
- ◆任意の断面、詳細データ表示が可能
- ◆探傷表示画面へ断面図を embed 込み可能